

BEST 全球半导体行业周报（2026-7-5 至 2026-7-15）

发布机构：百思特变革研究院 半导体智库

报告周期：2026-07-05 至 2026-07-15

读者定位：企业家、投资者、产业链研究专家、管理咨询专家

核验口径：公司 IR、政府、监管、交易所和产业协会优先；研究机构数据标注为估计；行情为最近可得复权收盘价。

本期总判断

过去十天，全球半导体行业的焦点是产能、长约和供应安全执行：5 月全球销售额升至 1,206 亿美元；Micron 把汽车长约、美国 DRAM 扩产、300mm 硅片保障并入同一资本体系；Intel、欧盟与美国政策继续推动区域化制造。下一阶段的核心问题不是需求是否存在，而是先进存储、封装测试、材料设备和本地化工程能否按期交付。



一、执行摘要：六个关键变化

- 全球销售规模继续上台阶。SIA 披露 2026 年 5 月全球半导体销售额为 1,206 亿美元，环比增长 9.2%、同比增长 104.1%，并连续第 15 个月环比增长。区域同比增幅分别为美洲 132.2%、亚太及其他 118.9%、中国 88.8%、欧洲 60.7%、日本 23.8%。这组数据证明 AI、存储和先进制造需求强，但区域和产品结构分化仍然明显。[S1]
- 存储行业开始把价格周期转化为长期供给安排。Micron 与 Ford 签署长期战略客户协议，并把汽车 DRAM 扩产、美国本土制造和长期供货纳入同一体系；此前与 GM 的类似安排也说明车企正通过长约降低内存与存储波动。[S4]
- 存储资本开支向上游材料延伸。Micron 把 2035 年前美国晶圆厂和技术投资计划提高至超过 2,500 亿美元，同时宣布最高 30 亿美元供应链投资，并向 GlobalWafers America 的 300mm 原始硅片项目提供 5 亿美元融资支持。供应安全已从成品颗粒扩展到原始硅片、化学品、设备和人才。[S5][S6]
- 韩国存储龙头同时验证利润和技术路线。Samsung 给出 2Q26 销售额约 171 万亿韩元、营业利润约 89.4 万亿韩元的指引；SK hynix 则把 HBM4/HBM4E、定制 HBM、AI-DRAM、AI-NAND/eSSD 和客户共同设计组合为全栈 AI 内存战略。完整分部业绩和客户认证仍是下一步核验重点。[S2][S3][S8]
- 区域化制造进入既有产线升级阶段。Intel 在爱尔兰 Leixlip 追加 50 亿欧元投资；欧盟 Chips Act 2.0 继续强化供应链平台、危机响应和成员国协同。产业政策的衡量标准正在从宣布金额转向设备安装、产品导入、良率、能源和人才供给。[S7][S17][S18]

- 先进封装、测试与材料成为第二约束。SEMI 发布全球封装测试设施数据库，并预计 2026 年测试设备和封装设备销售额分别增长约 12%和 9.2%；美国又针对部分服务于半导体的化工企业给予监管缓期。AI 芯片能否交付，越来越取决于后道产能和材料连续性。[S12][S13][S19]

二、本周重大事件矩阵

日期	领域	事件	产业含义	来源
07-06	全球/销售	SIA 公布 5 月全球半导体销售额 1,206 亿美元，环比 +9.2%、同比+104.1%，连续第 15 个月环比增长。	景气已扩展到 AI 全栈、存储和相关制造环节，但应继续拆分地区与产品结构。	S1
07-06	美国/汽车存储	Micron 与 Ford 签署长期战略客户协议，面向下一代汽车保障内存与存储供给。	汽车客户从季度采购转向长期供给、产能绑定和本地化制造。	S4
07-07	韩国/业绩	Samsung 给出 2Q26 销售额约 171 万亿韩元、营业利润约 89.4 万亿韩元的初步指引。	存储价格和 AI 内存盈利能力走强；分部收入、HBM 和资本开支仍待 7 月 30 日完整披露。	S2/S3
07-07	全球/封测	SEMI 发布 2026 Worldwide Assembly & Test Facility Database。	封装测试产能地图成为 AI 供应链规划、选址与韧性管理的基础数据。	S12
07-08	韩国/AI 内存	SK hynix 提出覆盖 HBM4/HBM4E、定制 HBM、AI-DRAM、AI-NAND/eSSD 的全栈路线。	存储厂商从标准品供货转向共同设计、热管理、固件和工作负载协同。	S8
07-08	中国/IPO	深圳基本半导体在港交所主板上市，全球发售 27,386,200 股 H 股。	SiC 功率半导体获得跨境融资平台，后续看车规客户、产能利用率与盈利质量。	S21
07-09	美国/DRAM 投资	Micron 把 2035 年前美国晶圆厂和技术投资计划提高至超过 2,500 亿美元，纽约 Clay 项目开始浇筑。	存储本地化进入工程执行；设备、材料、人才、电力和量产节拍成为约束。	S5
07-09	美国/300mm 硅片	Micron 宣布最高 30 亿美元供应链投资，并向 GlobalWafers America 提供 5 亿美元融资支持。	原始硅片被纳入长期供给保障，材料端的资本强度和客户绑定增强。	S6
07-09	日本/2nm	Rapidus 澄清媒体引用的每片晶圆预期价格并非实际销售价格，真实价格取决于规格和汇率。	2nm 商业化不能用单一媒体价格判断，必须同时核算良率、客户设计和成本结构。	S23
07-13	欧洲/制造	Intel 宣布在爱尔兰 Leixlip 投资 50 亿欧元，升级现有工厂并导入领先设备。	欧洲先进制造从新建产线转向既有工厂升级、研发与 Intel 3 产品交付。	S7
07-13	美国/材料政策	白宫给予部分服务于半导体等关键行业的化工企业两年监管缓期。	政策关注点深入高纯化学品和连续生产；企业仍需逐项确认适用范围与合规责任。	S19
07-15 截稿	中国台湾/业绩	TSMC 6 月营收未在公司月度页列示；2Q26 业绩会定于 7 月 16 日。	本期不推算缺失数字；下一期重点核验 390 亿—402 亿美元收入指引与先进封装产能。	S9/S10

三、区域与产业链观察

区域	主线	本周信号	关注度
美国	存储长约、本土 DRAM、300mm 硅片、化学品与关税边界	Micron 把 Ford 长约、>2,500 亿美元晶圆厂计划和 GlobalWafers 融资支持连接起来；白宫材料监管缓期显示供应安全下沉到化学品。	高
中国大陆/香港	成熟制程、SiC 功率、设备与跨境融资	基本半导体上市，晶集成完成全球发售流程；本土设备、AI 芯片和封测股表现分化。	高
中国台湾	先进制程、CoWoS 与 2Q26 业绩验证	TSMC 7 月 16 日公布 2Q26 业绩；截至截稿 6 月营收仍未列示，不能用市场预期替代公司数据。	高
韩国	HBM、DRAM、NAND 与全栈 AI 内存	Samsung 利润指引显著，SK hynix 把 HBM 扩展到 AI-DRAM、AI-NAND/eSSD 和客户共同设计。	高
日本	2nm 商业化、设备与测试	Rapidus 澄清晶圆价格口径；Tokyo Electron 与 Advantest 仍受益于先进逻辑、存储和测试复杂度。	中高
欧洲	既有工厂升级、EUV 与 Chips Act 2.0	Intel 在爱尔兰追加 50 亿欧元；欧盟政策转向供应链平台、危机响应和能力中心。	中高
东南亚	电子制造、封测与区域分工	新加坡 5 月半导体产出同比+37.0%、1—5 月+34.4%，显示区域产出对 AI 和存储周期高度敏感。	中高

各区域的半导体政策已进入制造交付阶段。美国强调存储、硅片和化学品；欧洲强调既有产线升级和跨国协同；韩国围绕 HBM 和全栈 AI 内存扩大优势；中国大陆和香港继续通过制造能力与资本市场对接扩大特色工艺、设备和功率半导体的融资空间。

四、产业链穿透框架

链条	本周信号	产业链传导	后续验证点
AI 芯片/ASIC	全球销售创新高，NVIDIA 和 Broadcom 股价本期分别+8.31%、+4.07%，但 SOX 整体-1.85%。	需求强不等于估值同步上升，交付、毛利和客户集中度成为主要分化变量。	云客户 capex、GPU/ASIC 交付、网络芯片收入、毛利率。
先进制程/晶圆代工	TSMC 业绩会待披露；Intel 向爱尔兰既有工厂追加 50 亿欧元。	先进节点竞争进入产线升级、客户导入、区域供给和资本效率共同验证阶段。	2nm/A16/Intel 3 良率、客户 tape-out、资本开支。
DRAM/HBM	Samsung 利润指引、Micron 美国投资、SK hynix 全栈路线共同确认存储业务的盈利能力和战略地位。	HBM 投片挤占传统 DRAM，客户以长约和共同设计提前锁定产能。	HBM4/4E 认证、投片占比、长约预付款、毛利率。
NAND/eSSD/成熟存储	AI-NAND/eSSD 进入 SK hynix 全栈路线；TrendForce 仍预期 NAND 和成熟存储合约价上行。	企业 SSD 与 AI 推理需求抬升 NAND 优先级，汽车和工业客户承受成本传导。	企业 SSD 出货、NAND 合约价、库存、车规供货。
先进封装/测试	SEMI 发布全球封装测试设施数据库，并预计测试和封装设备 2026 年增速领先。	后道产能从配套能力升级为 AI 芯片系统交付的第二瓶颈。	CoWoS/混合键合产能、测试时长、良率、设备订单。
设备/材料	Micron 支持 300mm 原始硅片项目；美国政策关注高纯化学品连续生产。	资本开支向硅片、化学品、检测和设备零部件扩散。	硅片长约、化学品适用清单、WFE/测试/封装设备订单。
EDA/IP/Chiplet	先进节点、定制 HBM 和 Chiplet 提高系统级设计验证复杂度。	Synopsys、Cadence、Arm 的价值来自 IP 复用、验证、接口标准和软件生态。	客户授权、RISC-V 采用、AI 辅助 EDA、先进封装协同。
汽车/功率半导体	Micron-Ford 长约与基本半导体上市分别覆盖汽车存储和 SiC 功率。	汽车供应链转向长周期产能保障，SiC 商业化要看车规认证和利用率。	长约规模、车规客户、SiC 良率、产能利用率。

产业链传导路径是：AI 算力需求提升 HBM、DRAM 和企业 SSD 的供给优先级；先进封装、测试、300mm 硅片、高纯化学品和设备安装决定交付节拍；长约、融资支持和区域化工厂把技术路线落实为中长期资本承诺。

五、供应链瓶颈、价值增量环节与验证指标

瓶颈	形成原因	价值增量环节	验证指标
HBM 与高容量 DRAM	AI 训练/推理优先吸收先进存储；HBM4/4E 验证周期长。	存储颗粒、先进封装、测试、设备材料。	HBM 认证、投片占比、长约、毛利率。
300mm 原始硅片	本土化 DRAM 扩产需要稳定的原始硅片、外延和材料供应。	硅片、石英、气体、化学品及本土材料项目。	融资落地、产线认证、客户长约、良率。
先进封装与测试	AI 芯片 die 尺寸、HBM 堆叠和测试时间同步上升。	CoWoS、混合键合、载板、测试设备、OSAT。	排产、测试时长、良率、设备交期。
高纯化学品	连续生产、环保规范和区域化供应共同影响材料可得性。	电子特气、湿电子化学品、过滤与配送系统。	政策适用范围、双源认证、库存天数。
先进光刻与量测	2nm、GAA、先进 DRAM 需要 EUV、High-NA 和更高频率检测。	光刻、掩模、量测、缺陷检测和计算光刻。	系统出货、装机利用率、客户 capex。
区域化工程执行	美国、欧洲新投资规模大，但受设备、人才、电力和许可制约。	工程服务、自动化、厂务、能源和培训。	开工、设备搬入、首片晶圆、良率爬坡。

各环节的收益取决于客户长约、扩产进度、良率、价格对资本成本的覆盖程度，以及替代技术的进展。

六、政策、出口管制、补贴与供应链安全

美国政策的最新信号落在材料连续性。7 月 13 日白宫给予部分服务于半导体、医疗和先进制造的化工企业两年监管缓期，政策目标是降低关键化学品停产对供应链的冲击。该措施不等于全面豁免，企业仍需逐项核对适用公司、化学品、排放要求和生效期限。[S19]

Section 232 既有措施继续对狭义覆盖的先进计算芯片征收 25%关税并设置多类豁免。截至 7 月 15 日截稿，本期未发现新的官方税率调整，因此不把市场传闻写成‘本周加税’。采购、报价和跨境交付仍应按产品、最终用途和豁免条件逐单核验。[S20]

欧洲 Chips Act 2.0 把政策重点从单点工厂补贴扩展到 B2B 供应链平台、危机监测、能力中心和成员国协调。欧委会称首版 Chips Act 相关 13 项国家援助决定代表超过 320 亿欧元公私投资；Chips Act 2.0 页面称已动员超过 520 亿欧

元并带来约 4.6 万个岗位。政策成效应以投产、客户、良率和区域协同核验。

[S17][S18]

Intel 爱尔兰投资与 Micron 美国投资说明区域化制造已进入工程执行阶段。企业应将政策补贴、设备到货、材料认证、人才招聘、电力保障和客户导入纳入统一项目管理。公告规模不等于有效产能。[S5][S7]

七、技术与产品趋势

先进制程：TSMC 将在 7 月 16 日发布 2Q26 实际业绩。公司当前指引为收入 390 亿—402 亿美元、毛利率 65.5%—67.5%、营业利润率 56.5%—58.5%。截至截稿，公司尚未披露 6 月营收。Intel 则通过爱尔兰既有工厂升级支持 Xeon 6 及下一代 Intel 3 产品，先进制程竞争进入量产执行和资本效率阶段。

[S7][S9][S10]

HBM 与 AI 内存：SK hynix 把 HBM4/HBM4E、定制 HBM、AI-DRAM、AI-NAND/eSSD 纳入同一战略，表明头部客户的采购范围已覆盖共同设计、热管理、封装、固件和工作负载优化。TrendForce 预计 HBM 投片占比继续提高，2027 年产能和价格谈判将更早启动。[S8][S15]

DRAM、NAND 与成熟存储：TrendForce 预计 2Q26 传统 DRAM 合约价环比上涨 58%—63%、NAND 上涨 70%—75%，并认为 NOR Flash、SLC NAND 仍存在结构性紧张。该数据属于研究机构估计，应通过 Samsung、SK hynix、Micron 后续分部收入、库存和 ASP 验证。[S14][S16]

先进封装与测试：SEMI 发布 2026 全球封装测试设施数据库，并预计 2026 年测试设备销售额增长约 12%、封装设备增长约 9.2%。随着 HBM 堆叠、多 die 封装和测试时长上升，后道能力将更直接地影响 AI 芯片可交付量。[S12][S13]

汽车与功率半导体：Micron-Ford 长约说明车规存储更强调长生命周期与连续供应；基本半导体上市为 SiC 功率器件提供新的融资平台。车规认证、产能利用率、良率、客户集中度和现金流是两条主线的核验重点。[S4][S21]

EDA/IP 与系统设计：定制 HBM、Chiplet 和先进封装把设计边界从单颗芯片扩大到系统。Synopsys、Cadence、Arm 以及 RISC-V 生态的竞争将集中在 IP 复用、接口标准、系统级验证、软件工具和客户迁移成本。

八、半导体装备制造链专题

环节	本周观察	代表企业/方向
光刻	ASML 2Q26 实际业绩截至截稿尚未在财务结果页发布；先进逻辑和 DRAM 仍依赖 EUV/High-NA 路线。	ASML、ZEISS、掩模、计算光刻；后续核验订单与客户装机。
刻蚀/薄膜/沉积	GAA、HBM、3D NAND 和混合键合增加高深宽比刻蚀、ALD/CVD 与材料工程步骤。	Applied Materials、Lam Research、Tokyo Electron、北方华创、中微公司。
检测量测	先进封装和多 die 系统扩大缺陷传导成本，量测与良率分析成为资本开支刚性环节。	KLA、Onto、Nova、国内检测量测厂商。
清洗/CMP/离子注入	先进节点和存储层数上升增加清洗、平坦化和掺杂步骤，既有工厂升级同样拉动需求。	SCREEN、Ebara、Axcelis、TEL 及国产平台设备。
晶圆材料	Micron 向 GlobalWafers America 300mm 项目提供 5 亿美元融资支持。	GlobalWafers、SUMCO、Shin-Etsu 及本地材料供应商。
封装设备	SEMI 预计 2026 年封装设备销售额增长约 9.2%，AI/HBM 推动键合、贴装和载板能力升级。	Besi、ASMPT、Kulicke & Soffa、国内封装设备链。
测试设备	SEMI 预计 2026 年测试设备销售额增长约 12%，高于 WFE 预测增速。	Advantest、Teradyne、测试接口与探针卡生态。
厂务与材料输送	高纯化学品政策变化和区域化建厂提高厂务连续性与合规要求。	电子特气、湿化学品、过滤、废气处理、自动物料搬运。

SEMI 预计 2026 年全球半导体设备销售额约 1,450 亿美元、2027 年约 1,560 亿美元，其中测试与封装设备的预测增速高于 WFE。设备资本开支已覆盖后道测试、材料、量测和既有产线升级。[S13]

九、重点企业动态

- TSMC: 7月16日发布2Q26业绩。收入、毛利率、先进节点占比、CoWoS供需和资本开支是下一期最重要的验证变量;截至截稿不使用缺失的6月营收数据。[S9][S10]

- Samsung Electronics: 2Q26初步指引为销售额约171万亿韩元、营业利润约89.4万亿韩元。7月30日完整业绩需核验存储分部、HBM、库存和资本开支。[S2][S3]

- SK hynix: 从HBM延伸到AI-DRAM、AI-NAND/eSSD和客户共同设计。战略价值在于把颗粒、封装、热管理和工作负载协同形成组合,但仍需验证HBM4/4E客户认证与产能兑现。[S8]

- Micron: 与Ford签署长期协议,将美国晶圆厂和技术投资提高至超过2,500亿美元,并向GlobalWafers America提供5亿美元融资支持。后续核验长期资本回报和工程交付。[S4][S5][S6]

- Intel: 爱尔兰Leixlip追加50亿欧元投资,支持Xeon 6与下一代Intel 3产品。7月23日业绩需核验Foundry亏损、客户导入、资本开支和18A/Intel 3进度。[S7][S25]

- NVIDIA: 本期无新增财务结果;7月6—14日复权收盘价上涨8.31%,明显强于SOX。后续跟踪GPU/网络交付、HBM与先进封装锁产、云客户资本开支和毛利率。

- AMD: 7月8日宣布8月4日发布2Q26业绩,并将在7月22—23日举行Advancing AI 2026活动。后续核验数据中心收入、AI加速器交付、服务器CPU和软件生态。[S11][S26]

- **Broadcom:** 本期股价上涨 4.07%，但本期没有新的正式业绩披露。后续核验定制 AI 加速器、网络芯片、客户集中度和收入确认。
- **ASML:** 截至截稿，2Q26 完整业绩尚未在公司财务结果页发布；不使用市场预期替代实际订单、销售和毛利率。EUV/High-NA 仍是 2nm 和先进 DRAM 的核心设备。[S27]
- **Applied Materials / Lam Research / KLA / Tokyo Electron:** 受益于 GAA、HBM、3D NAND、量测和既有工厂升级，但应分别核验订单、出口管制、客户资本开支和服务收入。
- **Synopsys / Cadence / Arm:** 先进节点、Chiplet 与定制 HBM 提高系统级设计复杂度；本期股价分别-3.70%、+0.27%、-12.75%，显示长期逻辑和短期估值并不一致。
- **SMIC / Hua Hong:** 成熟制程和特色工艺仍是中国晶圆制造基本盘。本期股价分别+0.97%、-3.65%；继续跟踪稼动率、ASP、客户结构和设备维护。
- **北方华创 / 中微公司:** 分别覆盖平台型设备和刻蚀/薄膜沉积等关键环节。本期股价分别-5.12%、-2.03%；后续核验订单质量、先进工艺验证和核心零部件自主能力。
- **寒武纪 / 海光信息:** 本期股价分别+4.29%、+4.75%，反映国产算力主线仍有交易强度；后续核验客户、收入、毛利、供应能力与软件生态。
- **长电科技:** 本期股价+13.01%，高于多数样本；后续核验高端业务占比、客户导入、设备利用率和现金流。

• 基本半导体 / 晶合集成：两家公司完成港股融资节点，分别代表 SiC 功率器件与成熟/特色工艺。上市后的核心指标是募集资金使用、产能利用率、良率、客户结构和盈利质量。[S21][S22]

• Rapidus：澄清媒体晶圆价格并非实际售价。其 2nm 商业化仍需验证客户设计、试产良率、量产时点、设备投资和汇率，而不能以单一价格数字推导竞争力。[S23]

十、投资、并购、融资、IPO、产能建设与合作

区域/类型	事项	规模/动作	产业含义与验证点	来源
美国/长约	Micron-Ford 战略客户协议	长期保障下一代汽车内存和存储；支持 Manassas 先进 DRAM 扩产。	验证车企是否以预付款、容量承诺和产品生命周期换取供给连续性。	S4
美国/晶圆厂	Micron 美国投资加速	2035 年前晶圆厂和技术投资>2,500 亿美元；目标 40% DRAM 在美国生产。	关注纽约、Idaho 开工和首片晶圆、设备搬入、人才与电力。	S5
美国/材料	Micron 供应链战略投资	最高 30 亿美元；向 GlobalWafers America 300mm 项目提供 5 亿美元融资支持。	上游硅片由采购项目变成资本合作和长期供给安排。	S6
欧洲/制造	Intel Leixlip 升级	投资 50 亿欧元，升级既有工厂并安装领先设备。	验证 Intel 3 产品、Xeon 6 和下一代 Xeon 的量产与客户需求。	S7
中国/IPO	基本半导体港股上市	全球发售 27,386,200 股 H 股。	关注 SiC 车规客户、产能利用率、良率和募集资金用途。	S21
中国/IPO	晶合集成 H 股全球发售	全球发售 216,167,000 股 H 股。	关注显示驱动/特色工艺需求、稼动率、ASP 和资本开支纪律。	S22
欧盟/政策	Chips Act 2.0	首版计划 13 项国家援助决定对应>320 亿欧元公私投资；2.0 强化协同。	政策成效应以投产、岗位、客户和区域供应链联动验证。	S17/S18

资本动作集中在客户和关键上游绑定：Micron 同时绑定汽车客户、美国制造和 300mm 硅片；Intel 在欧洲升级既有制造；中国企业通过港股融资支持功率和特色工艺。这些动作的价值取决于客户承诺、工程进度、良率和自由现金流。

十一、资本市场表现快照

口径说明：下表为 Yahoo Finance/yfinance 于 2026 年 7 月 15 日抓取的最近可得复权收盘价。美股区间为 7 月 6 日至 7 月 14 日，亚洲市场多数为 7 月 3 日至

7月14日；各市场币种和交易日不同。价格受公司行动和复权影响，仅用于区间比较，不构成投资建议。

标的	代码	区间	期初	期末	涨跌幅	币种
费城半导体指数	^SOX	2026-07-06 → 2026-07-14	12,900.14	12,661.93	-1.85%	USD
NVIDIA	NVDA	2026-07-06 → 2026-07-14	195.55	211.80	+8.31%	USD
AMD	AMD	2026-07-06 → 2026-07-14	552.05	548.13	-0.71%	USD
Broadcom	AVGO	2026-07-06 → 2026-07-14	373.90	389.11	+4.07%	USD
Intel	INTC	2026-07-06 → 2026-07-14	122.20	107.76	-11.82%	USD
Micron	MU	2026-07-06 → 2026-07-14	984.75	983.12	-0.17%	USD
TSMC ADR	TSM	2026-07-06 → 2026-07-14	451.79	420.39	-6.95%	USD
ASML	ASML	2026-07-06 → 2026-07-14	1,825.07	1,775.64	-2.71%	USD
Applied Materials	AMAT	2026-07-06 → 2026-07-14	592.79	595.70	+0.49%	USD
Lam Research	LRCX	2026-07-06 → 2026-07-14	350.20	346.10	-1.17%	USD
KLA	KLAC	2026-07-06 → 2026-07-14	233.31	230.37	-1.26%	USD
Arm	ARM	2026-07-06 → 2026-07-14	322.24	281.17	-12.75%	USD
Synopsys	SNPS	2026-07-06 → 2026-07-14	442.27	425.90	-3.70%	USD
Cadence	CDNS	2026-07-06 → 2026-07-14	375.77	376.80	+0.27%	USD
Qualcomm	QCOM	2026-07-06 → 2026-07-14	186.48	178.10	-4.49%	USD
Samsung Electronics	005930.KS	2026-07-03 → 2026-07-14	309,500.00	263,000.00	-15.02%	KRW
SK hynix	000660.KS	2026-07-03 → 2026-07-14	2,425,000.00	1,913,000.00	-21.11%	KRW
TSMC	2330.TW	2026-07-03 → 2026-07-14	2,445.00	2,420.00	-1.02%	TWD

标的	代码	区间	期初	期末	涨跌幅	币种
MediaTek	2454.TW	2026-07-03 → 2026-07-14	4,170.08	3,660.00	-12.23%	TWD
Tokyo Electron	8035.T	2026-07-03 → 2026-07-14	73,200.00	71,130.00	-2.83%	JPY
Advantest	6857.T	2026-07-03 → 2026-07-14	29,345.00	29,775.00	+1.47%	JPY
SMIC	0981.HK	2026-07-03 → 2026-07-14	77.60	78.35	+0.97%	HKD
Hua Hong	1347.HK	2026-07-03 → 2026-07-14	178.00	171.50	-3.65%	HKD
北方华创	002371.SZ	2026-07-03 → 2026-07-14	816.00	774.20	-5.12%	CNY
中微公司	688012.SS	2026-07-03 → 2026-07-14	413.69	405.30	-2.03%	CNY
寒武纪	688256.SS	2026-07-03 → 2026-07-14	1,353.00	1,411.00	+4.29%	CNY
海光信息	688041.SS	2026-07-03 → 2026-07-14	325.40	340.85	+4.75%	CNY
兆易创新	603986.SS	2026-07-03 → 2026-07-14	677.77	583.99	-13.84%	CNY
长电科技	600584.SS	2026-07-03 → 2026-07-14	90.88	102.70	+13.01%	CNY

市场解读：SOX 区间下跌 1.85%，但 NVIDIA 上涨 8.31%、Broadcom 上涨 4.07%；Intel、Arm、Samsung、SK hynix、MediaTek 和兆易创新跌幅较大，长电科技上涨 13.01%。这说明总量数据强劲并未形成普涨，市场正在交易公司执行、估值、资本开支和事件兑现。

十二、供需、价格、库存、产能与风险信号

主题	本周信号	产业影响	验证指标
全球需求	5月销售额 1,206 亿美元、环比+9.2%，但 SOX 7月 6—14 日-1.85%。	基本面强与估值/事件兑现分化，不能用指数代替供需判断。	区域销售、企业收入、订单、库存。
DRAM/HBM	TrendForce 预计 2Q26 传统 DRAM 合约价环比+58%—63%，HBM 投片占比继续提升。	服务器和 AI 优先级挤压传统终端，客户加速签订长约。	合约价、HBM 认证、投片、客户预付款。
NAND/成熟存储	TrendForce 预计 2Q26 NAND 合约价环比+70%—75%，NOR/SLC NAND 仍偏紧。	企业 SSD 受益，PC、汽车和工业 BOM 承压。	企业 SSD 需求、库存、车规交期。
先进封装/测试	封装测试设施数据库发布，测试设备预测增速高于 WFE。	产能规划和测试节拍会约束 AI 芯片可交付量。	CoWoS 产能、测试时长、良率、设备订单。
材料连续性	300mm 硅片融资支持和化工监管延期同时出现。	上游材料成为区域化制造的先决条件。	双源认证、库存、政策清单、长约。
政策/关税	Section 232 既有 25%措施仍在；截至截稿未找到本周新的官方税率调整。	企业应持续做物项、最终用途和豁免条件核验，避免把传闻写入报价。	官方公告、海关口径、客户合同。
工程执行	美国和欧洲项目规模大、工期长。	设备、能源、厂务、人才和当地许可可能延后收入兑现。	开工、设备搬入、首片晶圆、良率。

供需判断要同时看数量、价格、库存、长约和产能兑现。销售额创新高证明需求强，长约和上游融资证明企业担忧连续供应；但资本项目周期长、股票表现分化，说明市场已经开始区分‘需求存在’和‘企业能否兑现利润’。

十三、管理观察与行动建议

- 供应保障应覆盖产能与材料配置。Micron-Ford、Micron-GlobalWafers 两类安排显示，头部企业同时使用长约、融资支持、本地化产能和产品生命周期承诺；一级供应商管理不足以覆盖风险。

- 资本项目应建立工程里程碑台账。对美国、欧洲晶圆厂和封装测试项目，按开工、设备搬入、首片晶圆、客户认证、量产良率和现金流六个节点评估有效产能。

- 存储采购要区分 HBM、服务器 DRAM、企业 SSD、车规内存和成熟存储。不同产品的认证周期、产能替代性和价格机制不同；统一议价会掩盖真正的缺口与库存风险。

- 对 AI 基础设施项目，应把先进封装、测试、网络、功率、散热和材料列入与 GPU 同级的交付清单。最慢环节决定系统交付进度。

- 对政策信息保持可审计口径。关税、出口管制、环保缓期和补贴都应落实到物项、法人、最终用途、工厂和生效日期，不以媒体标题替代法务与供应链核验。

对象	建议
企业经营者	对 HBM/DRAM、300mm 硅片、先进封装测试、高纯化学品建立二级供应地图；对关键料分别设定长约、双源、库存和替代设计。
供应链负责人	把供应商评估从价格/交期扩展到资本开支、工程里程碑、区域合规、客户集中度和产品生命周期承诺。
投资与研究团队	将每项资本公告拆成‘规模—时间—产能—客户—良率—现金流’，并区分公司官方事实、协会预测和研究机构估计。
管理咨询团队	围绕产能爬坡、良率、S&OP、材料双源、研发项目组合、全球工厂协同和供应链风险设计可量化改善项目。

公众号 · BEST变革力量

十四、半导体知识点

战略客户协议（SCA）

一句话定义：半导体供应商与客户围绕长期容量、产品路线、供货优先级和商业条件签订的中长期协议。

为什么本周重要：Micron 与 Ford 的协议说明汽车客户正在用长期承诺换取内存与存储的连续供应。

企业/投资/管理含义：企业不应把 SCA 等同于普通采购框架；需评估预付款、最低采购量、价格机制、产品变更和客户集中度。

300mm 原始硅片供应保障

一句话定义：300mm 原始硅片是先进逻辑和 DRAM 制造的基础材料，其认证周期、缺陷水平和供给稳定性直接影响晶圆厂扩产。

为什么本周重要：Micron 向 GlobalWafers America 提供 5 亿美元融资支持，说明硅片已从通用采购品升级为战略产能。

企业/投资/管理含义：晶圆厂应同步管理硅片长约、第二来源、区域供应、质量认证和扩产节拍；投资评估需关注利用率和客户绑定。

十五、下周待跟踪信号

TSMC 将于 7 月 16 日发布 2Q26 实际业绩，重点核验收入 390 亿—402 亿美元指引、毛利率 65.5%—67.5%、先进节点与 CoWoS 供需。[S9]

- Intel 计划 7 月 23 日发布 2Q26 业绩，重点核验 Foundry 亏损、Intel 3/18A 客户进度、爱尔兰投资节奏和资本开支。[S7][S25]

- AMD 将于 7 月 22—23 日举行 Advancing AI 2026 活动、8 月 4 日发布 2Q26 业绩；跟踪 AI 加速器、服务器 CPU、网络与软件生态。[S11][S26]

- Samsung 将于 7 月 30 日发布 2Q26 完整业绩；核验 HBM、DRAM/NAND 分部收入、毛利、库存和资本开支是否支持初步指引。[S2][S3]

- Micron 纽约和 Idaho 项目需按季度跟踪工程进度、设备搬入、首片晶圆、联邦/地方资金和人才供给。[S5]

- Micron-GlobalWafers 融资支持需跟踪产线认证、产能爬坡、长期供给条款及其对 300mm 硅片区域价格的影响。[S6]

- HBM4/HBM4E 进入客户认证和 2027 年产能谈判阶段，需跟踪三大供应商投片、封装良率、客户共同设计和价格机制。[S8][S15]

- 美国 Section 232 和材料监管缓期需持续核验正式清单、豁免和生效口径，避免把政策信号直接写成所有产品统一成本变化。[S19][S20]

- 基本半导体与晶合集成上市后，需跟踪募集资金投向、产能利用率、车规/显示客户、毛利率和现金流。[S21][S22]

来源附录与链接

[S1] SIA: 2026 年 5 月全球半导体销售额

[S2] Samsung Electronics: 2Q26 业绩指引

[S3] Samsung Electronics: 2Q26 完整业绩发布日期

[S4] Micron 与 Ford 签署长期战略客户协议

[S5] Micron: 加速美国投资并在纽约项目浇筑首块混凝土

[S6] Micron: 美国半导体供应链战略投资及 GlobalWafers 融资支持

[S7] Intel: 在爱尔兰 Leixlip 投资 50 亿欧元

[S8] SK hynix: 从 HBM 到 eSSD 的全栈 AI 内存战略

[S9] TSMC: 2Q26 业绩会、指引与静默期

[S10] TSMC: 2026 年月度营收

[S11] AMD: 2Q26 业绩发布日期公告

[S12] SEMI: 2026 Worldwide Assembly & Test Facility Database

- [S13] SEMI：2026—2027 全球半导体设备销售额预测
- [S14] TrendForce：2Q26 DRAM 与 NAND 合约价预测
- [S15] TrendForce：HBM 投片占比与 HBM4 谈判观察
- [S16] TrendForce：NOR Flash 与 SLC NAND 价格观察
- [S17] 欧盟委员会：European Chips Act
- [S18] 欧盟委员会：Chips Act 2.0
- [S19] 美国白宫：面向半导体等关键行业的化工监管缓期
- [S20] 美国白宫：半导体及相关产品 Section 232 措施
- [S21] 港交所：深圳基本半导体上市文件
- [S22] 港交所：合肥晶合集成全球发售文件
- [S23] Rapidus：关于媒体所述晶圆价格的澄清
- [S24] 新加坡 EDB：2026 年 5 月制造业表现
- [S25] Intel：2Q26 业绩发布日期
- [S26] AMD：Advancing AI 2026 活动与投资者新闻
- [S27] ASML：财务结果页面

报告周期：2026-07-05 至 2026-07-15

读者定位：企业家、投资者、产业链研究专家、管理咨询专家

核验口径：公司 IR、政府、监管、交易所和产业协会优先；研究机构数据标注为估计；行情为最近可得复权收盘价。

本期总判断

过去十天，全球半导体行业的焦点是产能、长约和供应安全执行：5 月全球销售额升至 1,206 亿美元；Micron 把汽车长约、美国 DRAM 扩产、300mm 硅片保障并入同一资本体系；Intel、欧盟与美国政策继续推动区域化制造。下一阶段的核心问题不是需求是否存在，而是先进存储、封装测试、材料设备和本地化工程能否按期交付。

全球半导体行业周报

发布机构 | 百思特变革研究院 半导体智库

报告日期：2026-7-5 至 2026-7-15

芯片制造 | 先进封装 | AI算力 | 供应链

公众号：BEST变革力量

一、执行摘要：六个关键变化

- 全球销售规模继续上台阶。SIA 披露 2026 年 5 月全球半导体销售额为 1,206 亿美元，环比增长 9.2%、同比增长 104.1%，并连续第 15 个月环比增长。区域同比增幅分别为美洲 132.2%、亚太及其他 118.9%、中国 88.8%、欧洲 60.7%、日本 23.8%。这组数据证明 AI、存储和先进制造需求强，但区域和产品结构分化仍然明显。[S1]
- 存储行业开始把价格周期转化为长期供给安排。Micron 与 Ford 签署长期战略客户协议，并把汽车 DRAM 扩产、美国本土制造和长期供货纳入同一体系；此前与 GM 的类似安排也说明车企正通过长约降低内存与存储波动。[S4]
- 存储资本开支向上游材料延伸。Micron 把 2035 年前美国晶圆厂和技术投资计划提高至超过 2,500 亿美元，同时宣布最高 30 亿美元供应链投资，并向 GlobalWafers America 的 300mm 原始硅片项目提供 5 亿美元融资支持。供应安全已从成品颗粒扩展到原始硅片、化学品、设备和人才。[S5][S6]

- 韩国存储龙头同时验证利润和技术路线。Samsung 给出 2Q26 销售额约 171 万亿韩元、营业利润约 89.4 万亿韩元的指引；SK hynix 则把 HBM4/HBM4E、定制 HBM、AI-DRAM、AI-NAND/eSSD 和客户共同设计组合为全栈 AI 内存战略。完整分部业绩和客户认证仍是下一步核验重点。[S2][S3][S8]
- 区域化制造进入既有产线升级阶段。Intel 在爱尔兰 Leixlip 追加 50 亿欧元投资；欧盟 Chips Act 2.0 继续强化供应链平台、危机响应和成员国协同。产业政策的衡量标准正在从宣布金额转向设备安装、产品导入、良率、能源和人才供给。[S7][S17][S18]
- 先进封装、测试与材料成为第二约束。SEMI 发布全球封装测试设施数据库，并预计 2026 年测试设备和封装设备销售额分别增长约 12%和 9.2%；美国又针对部分服务于半导体的化工企业给予监管缓期。AI 芯片能否交付，越来越取决于后道产能和材料连续性。[S12][S13][S19]

二、本周重大事件矩阵

日期	领域	事件	产业含义	来源
07-06	全球/销售	SIA 公布 5 月全球半导体销售额 1,206 亿美元，环比 +9.2%、同比+104.1%，连续第 15 个月环比增长。	景气已扩展到 AI 全栈、存储和相关制造环节，但应继续拆分地区与产品结构。	S1
07-06	美国/汽车存储	Micron 与 Ford 签署长期战略客户协议，面向下一代汽车保障内存与存储供给。	汽车客户从季度采购转向长期供给、产能绑定和本地化制造。	S4
07-07	韩国/业绩	Samsung 给出 2Q26 销售额约 171 万亿韩元、营业利润约 89.4 万亿韩元的初步指引。	存储价格和 AI 内存盈利能力走强；分部收入、HBM 和资本开支仍待 7 月 30 日完整披露。	S2/S3
07-07	全球/封测	SEMI 发布 2026 Worldwide Assembly & Test Facility Database。	封装测试产能地图成为 AI 供应链规划、选址与韧性管理的基础数据。	S12
07-08	韩国/AI 内存	SK hynix 提出覆盖 HBM4/HBM4E、定制 HBM、AI-DRAM、AI-NAND/eSSD 的全栈路线。	存储厂商从标准品供货转向共同设计、热管理、固件和工作负载协同。	S8
07-08	中国/IPO	深圳基本半导体在港交所主板上市，全球发售 27,386,200 股 H 股。	SiC 功率半导体获得跨境融资平台，后续看车规客户、产能利用率与盈利质量。	S21
07-09	美国/DRAM 投资	Micron 把 2035 年前美国晶圆厂和技术投资计划提高至超过 2,500 亿美元，纽约 Clay 项目开始浇筑。	存储本地化进入工程执行；设备、材料、人才、电力和量产节拍成为约束。	S5
07-09	美国/300mm 硅片	Micron 宣布最高 30 亿美元供应链投资，并向 GlobalWafers America 提供 5 亿美元融资支持。	原始硅片被纳入长期供给保障，材料端的资本强度和客户绑定增强。	S6
07-09	日本/2nm	Rapidus 澄清媒体引用的每片晶圆预期价格并非实际销售价格，真实价格取决于规格和汇率。	2nm 商业化不能用单一媒体价格判断，必须同时核算良率、客户设计和成本结构。	S23
07-13	欧洲/制造	Intel 宣布在爱尔兰 Leixlip 投资 50 亿欧元，升级现有工厂并导入领先设备。	欧洲先进制造从新建产线转向既有工厂升级、研发与 Intel 3 产品交付。	S7
07-13	美国/材料政策	白宫给予部分服务于半导体等关键行业的化工企业两年监管缓期。	政策关注点深入高纯化学品和连续生产；企业仍需逐项确认适用范围与合规责任。	S19
07-15 截稿	中国台湾/业绩	TSMC 6 月营收末在公司月度页列示；2Q26 业绩会定于 7 月 16 日。	本期不推算缺失数字；下一期重点核算 390 亿—402 亿美元收入指引与先进封装产能。	S9/S10

三、区域与产业链观察

区域	主线	本周信号	关注度
美国	存储长约、本土 DRAM、300mm 硅片、化学品与关税边界	Micron 把 Ford 长约、>2,500 亿美元晶圆厂计划和 GlobalWafers 融资支持连接起来；白宫材料监管缓期显示供应安全下沉到化学品。	高
中国大陆/香港	成熟制程、SiC 功率、设备与跨境融资	基本半导体上市，晶集成完成全球发售流程；本土设备、AI 芯片和封测股表现分化。	高
中国台湾	先进制程、CoWoS 与 2Q26 业绩验证	TSMC 7 月 16 日公布 2Q26 业绩；截至截稿 6 月营收仍未列示，不能用市场预期替代公司数据。	高
韩国	HBM、DRAM、NAND 与全栈 AI 内存	Samsung 利润指引显著，SK hynix 把 HBM 扩展到 AI-DRAM、AI-NAND/eSSD 和客户共同设计。	高
日本	2nm 商业化、设备与测试	Rapidus 澄清晶圆价格口径；Tokyo Electron 与 Advantest 仍受益于先进逻辑、存储和测试复杂度。	中高
欧洲	既有工厂升级、EUV 与 Chips Act 2.0	Intel 在爱尔兰追加 50 亿欧元；欧盟政策转向供应链平台、危机响应和能力中心。	中高
东南亚	电子制造、封测与区域分工	新加坡 5 月半导体产出同比+37.0%、1—5 月+34.4%，显示区域产出对 AI 和存储周期高度敏感。	中高

各区域的半导体政策已进入制造交付阶段。美国强调存储、硅片和化学品；欧洲强调既有产线升级和跨国协同；韩国围绕 HBM 和全栈 AI 内存扩大优势；中国大陆和香港继续通过制造能力与资本市场对接扩大特色工艺、设备和功率半导体的融资空间。

四、产业链穿透框架

链条	本周信号	产业链传导	后续验证点
AI 芯片/ASIC	全球销售创新高，NVIDIA 和 Broadcom 股价本期分别+8.31%、+4.07%，但 SOX 整体-1.85%。	需求强不等于估值同步上升，交付、毛利和客户集中度成为主要分化变量。	云客户 capex、GPU/ASIC 交付、网络芯片收入、毛利率。
先进制程/晶圆代工	TSMC 业绩会待披露；Intel 向爱尔兰既有工厂追加 50 亿欧元。	先进节点竞争进入产线升级、客户导入、区域供给和资本效率共同验证阶段。	2nm/A16/Intel 3 良率、客户 tape-out、资本开支。
DRAM/HBM	Samsung 利润指引、Micron 美国投资、SK hynix 全栈路线共同确认存储业务的盈利能力和战略地位。	HBM 投片挤占传统 DRAM，客户以长约和共同设计提前锁定产能。	HBM4/4E 认证、投片占比、长约预付款、毛利率。
NAND/eSSD/成熟存储	AI-NAND/eSSD 进入 SK hynix 全栈路线；TrendForce 仍预期 NAND 和成熟存储合约价上行。	企业 SSD 与 AI 推理需求抬升 NAND 优先级，汽车和工业客户承受成本传导。	企业 SSD 出货、NAND 合约价、库存、车规供货。
先进封装/测试	SEMI 发布全球封装测试设施数据库，并预计测试和封装设备 2026 年增速领先。	后道产能从配套能力升级为 AI 芯片系统交付的第二瓶颈。	CoWoS/混合键合产能、测试时长、良率、设备订单。
设备/材料	Micron 支持 300mm 原始硅片项目；美国政策关注高纯化学品连续生产。	资本开支向硅片、化学品、检测和设备零部件扩散。	硅片长约、化学品适用清单、WFE/测试/封装设备订单。
EDA/IP/Chiplet	先进节点、定制 HBM 和 Chiplet 提高系统级设计验证复杂度。	Synopsys、Cadence、Arm 的价值来自 IP 复用、验证、接口标准和软件生态。	客户授权、RISC-V 采用、AI 辅助 EDA、先进封装协同。
汽车/功率半导体	Micron-Ford 长约与基本半导体上市分别覆盖汽车存储和 SiC 功率。	汽车供应链转向长周期产能保障，SiC 商业化要看车规认证和利用率。	长约规模、车规客户、SiC 良率、产能利用率。

产业链传导路径是：AI 算力需求提升 HBM、DRAM 和企业 SSD 的供给优先级；先进封装、测试、300mm 硅片、高纯化学品和设备安装决定交付节拍；长约、融资支持和区域化工厂把技术路线落实为中长期资本承诺。

五、供应链瓶颈、价值增量环节与验证指标

瓶颈	形成原因	价值增量环节	验证指标
HBM 与高容量 DRAM	AI 训练/推理优先吸收先进存储；HBM4/4E 验证周期长。	存储颗粒、先进封装、测试、设备材料。	HBM 认证、投片占比、长约、毛利率。
300mm 原始硅片	本土化 DRAM 扩产需要稳定的原始硅片、外延和材料供应。	硅片、石英、气体、化学品及本土材料项目。	融资落地、产线认证、客户长约、良率。
先进封装与测试	AI 芯片 die 尺寸、HBM 堆叠和测试时间同步上升。	CoWoS、混合键合、载板、测试设备、OSAT。	排产、测试时长、良率、设备交期。
高纯化学品	连续生产、环保规范和区域化供应共同影响材料可得性。	电子特气、湿电子化学品、过滤与配送系统。	政策适用范围、双源认证、库存天数。
先进光刻与量测	2nm、GAA、先进 DRAM 需要 EUV、High-NA 和更高频率检测。	光刻、掩模、量测、缺陷检测和计算光刻。	系统出货、装机利用率、客户 capex。
区域化工程执行	美国、欧洲新投资规模大，但受设备、人才、电力和许可制约。	工程服务、自动化、厂务、能源和培训。	开工、设备搬入、首片晶圆、良率爬坡。

各环节的收益取决于客户长约、扩产进度、良率、价格对资本成本的覆盖程度，以及替代技术的进展。

六、政策、出口管制、补贴与供应链安全

美国政策的最新信号落在材料连续性。7 月 13 日白宫给予部分服务于半导体、医疗和先进制造的化工企业两年监管缓期，政策目标是降低关键化学品停产对供应链的冲击。该措施不等于全面豁免，企业仍需逐项核对适用公司、化学品、排放要求和生效期限。[S19]

Section 232 既有措施继续对狭义覆盖的先进计算芯片征收 25%关税并设置多类豁免。截至 7 月 15 日截稿，本期未发现新的官方税率调整，因此不把市场传闻写成‘本周加税’。采购、报价和跨境交付仍应按产品、最终用途和豁免条件逐单核验。[S20]

欧洲 Chips Act 2.0 把政策重点从单点工厂补贴扩展到 B2B 供应链平台、危机监测、能力中心和成员国协调。欧委会称首版 Chips Act 相关 13 项国家援助决定代表超过 320 亿欧元公私投资；Chips Act 2.0 页面称已动员超过 520 亿欧

元并带来约 4.6 万个岗位。政策成效应以投产、客户、良率和区域协同核验。
[S17][S18]

Intel 爱尔兰投资与 Micron 美国投资说明区域化制造已进入工程执行阶段。企业应将政策补贴、设备到货、材料认证、人才招聘、电力保障和客户导入纳入统一项目管理。公告规模不等于有效产能。[S5][S7]

七、技术与产品趋势

先进制程：TSMC 将在 7 月 16 日发布 2Q26 实际业绩。公司当前指引为收入 390 亿—402 亿美元、毛利率 65.5%—67.5%、营业利润率 56.5%—58.5%。截至截稿，公司尚未披露 6 月营收。Intel 则通过爱尔兰既有工厂升级支持 Xeon 6 及下一代 Intel 3 产品，先进制程竞争进入量产执行和资本效率阶段。
[S7][S9][S10]

HBM 与 AI 内存：SK hynix 把 HBM4/HBM4E、定制 HBM、AI-DRAM、AI-NAND/eSSD 纳入同一战略，表明头部客户的采购范围已覆盖共同设计、热管理、封装、固件和工作负载优化。TrendForce 预计 HBM 投片占比继续提高，2027 年产能和价格谈判将更早启动。[S8][S15]

DRAM、NAND 与成熟存储：TrendForce 预计 2Q26 传统 DRAM 合约价环比上涨 58%—63%、NAND 上涨 70%—75%，并认为 NOR Flash、SLC NAND 仍存在结构性紧张。该数据属于研究机构估计，应通过 Samsung、SK hynix、Micron 后续分部收入、库存和 ASP 验证。[S14][S16]

先进封装与测试：SEMI 发布 2026 全球封装测试设施数据库，并预计 2026 年测试设备销售额增长约 12%、封装设备增长约 9.2%。随着 HBM 堆叠、多 die 封装和测试时长上升，后道能力将更直接地影响 AI 芯片可交付量。[S12][S13]

汽车与功率半导体：Micron-Ford 长约说明车规存储更强调长生命周期与连续供应；基本半导体上市为 SiC 功率器件提供新的融资平台。车规认证、产能利用率、良率、客户集中度和现金流是两条主线的核验重点。[S4][S21]

EDA/IP 与系统设计：定制 HBM、Chiplet 和先进封装把设计边界从单颗芯片扩大到系统。Synopsys、Cadence、Arm 以及 RISC-V 生态的竞争将集中在 IP 复用、接口标准、系统级验证、软件工具和客户迁移成本。

八、半导体装备制造链专题

环节	本周观察	代表企业/方向
光刻	ASML 2Q26 实际业绩截至截稿尚未在财务结果页发布；先进逻辑和 DRAM 仍依赖 EUV/High-NA 路线。	ASML、ZEISS、掩模、计算光刻；后续核验订单与客户装机。
刻蚀/薄膜/沉积	GAA、HBM、3D NAND 和混合键合增加高深宽比刻蚀、ALD/CVD 与材料工程步骤。	Applied Materials、Lam Research、Tokyo Electron、北方华创、中微公司。
检测量测	先进封装和多 die 系统扩大缺陷传导成本，量测与良率分析成为资本开支刚性环节。	KLA、Onto、Nova、国内检测量测厂商。
清洗/CMP/离子注入	先进节点和存储层数上升增加清洗、平坦化和掺杂步骤，既有工厂升级同样拉动需求。	SCREEN、Ebara、Axcelis、TEL 及国产平台设备。
晶圆材料	Micron 向 GlobalWafers America 300mm 项目提供 5 亿美元融资支持。	GlobalWafers、SUMCO、Shin-Etsu 及本地材料供应商。
封装设备	SEMI 预计 2026 年封装设备销售额增长约 9.2%，AI/HBM 推动键合、贴装和载板能力升级。	Besi、ASMPT、Kulicke & Soffa、国内封装设备链。
测试设备	SEMI 预计 2026 年测试设备销售额增长约 12%，高于 WFE 预测增速。	Advantest、Teradyne、测试接口与探针卡生态。
厂务与材料输送	高纯化学品政策变化和区域化建厂提高厂务连续性与合规要求。	电子特气、湿化学品、过滤、废气处理、自动物料搬运。

SEMI 预计 2026 年全球半导体设备销售额约 1,450 亿美元、2027 年约 1,560 亿美元，其中测试与封装设备的预测增速高于 WFE。设备资本开支已覆盖后道测试、材料、量测和既有产线升级。[S13]

九、重点企业动态

- TSMC：7 月 16 日发布 2Q26 业绩。收入、毛利率、先进节点占比、CoWoS 供需和资本开支是下一期最重要的验证变量；截至截稿不使用缺失的 6 月营收数据。[S9][S10]

- Samsung Electronics：2Q26 初步指引为销售额约 171 万亿韩元、营业利润约 89.4 万亿韩元。7 月 30 日完整业绩需核验存储分部、HBM、库存和资本开支。[S2][S3]

- SK hynix：从 HBM 延伸到 AI-DRAM、AI-NAND/eSSD 和客户共同设计。战略价值在于把颗粒、封装、热管理和工作负载协同形成组合，但仍需验证 HBM4/4E 客户认证与产能兑现。[S8]

- Micron：与 Ford 签署长期协议，将美国晶圆厂和技术投资提高至超过 2,500 亿美元，并向 GlobalWafers America 提供 5 亿美元融资支持。后续核验长期资本回报和工程交付。[S4][S5][S6]

- Intel：爱尔兰 Leixlip 追加 50 亿欧元投资，支持 Xeon 6 与下一代 Intel 3 产品。7 月 23 日业绩需核验 Foundry 亏损、客户导入、资本开支和 18A/Intel 3 进度。[S7][S25]

- NVIDIA：本期无新增财务结果；7月6—14日复权收盘价上涨8.31%，明显强于SOX。后续跟踪GPU/网络交付、HBM与先进封装锁产、云客户资本开支和毛利率。

- AMD：7月8日宣布8月4日发布2Q26业绩，并将在7月22—23日举行Advancing AI 2026活动。后续核验数据中心收入、AI加速器交付、服务器CPU和软件生态。[S11][S26]

- Broadcom：本期股价上涨4.07%，但本期没有新的正式业绩披露。后续核验定制AI加速器、网络芯片、客户集中度和收入确认。

- ASML：截至截稿，2Q26完整业绩尚未在公司财务结果页发布；不使用市场预期替代实际订单、销售和毛利率。EUV/High-NA仍是2nm和先进DRAM的核心设备。[S27]

- Applied Materials / Lam Research / KLA / Tokyo Electron：受益于GAA、HBM、3D NAND、量测和既有工厂升级，但应分别核验订单、出口管制、客户资本开支和服务收入。

- Synopsys / Cadence / Arm：先进节点、Chiplet与定制HBM提高系统级设计复杂度；本期股价分别-3.70%、+0.27%、-12.75%，显示长期逻辑和短期估值并不一致。

- SMIC / Hua Hong: 成熟制程和特色工艺仍是中国晶圆制造基本盘。本期股价分别+0.97%、-3.65%; 继续跟踪稼动率、ASP、客户结构和设备维护。

- 北方华创 / 中微公司: 分别覆盖平台型设备和刻蚀/薄膜沉积等关键环节。本期股价分别-5.12%、-2.03%; 后续核验订单质量、先进工艺验证和核心零部件自主能力。

- 寒武纪 / 海光信息: 本期股价分别+4.29%、+4.75%, 反映国产算力主线仍有交易强度; 后续核验客户、收入、毛利、供应能力与软件生态。

- 长电科技: 本期股价+13.01%, 高于多数样本; 后续核验高端业务占比、客户导入、设备利用率和现金流。

- 基本半导体 / 晶合集成: 两家公司完成港股融资节点, 分别代表 SiC 功率器件与成熟/特色工艺。上市后的核心指标是募集资金使用、产能利用率、良率、客户结构和盈利质量。[S21][S22]

- Rapidus: 澄清媒体晶圆价格并非实际售价。其 2nm 商业化仍需验证客户设计、试产良率、量产时点、设备投资和汇率, 而不能以单一价格数字推导竞争力。[S23]

十、投资、并购、融资、IPO、产能建设与合作

区域/类型	事项	规模/动作	产业含义与验证点	来源
美国/长约	Micron-Ford 战略客户协议	长期保障下一代汽车内存和存储；支持 Manassas 先进 DRAM 扩产。	验证车企是否以预付款、容量承诺和产品生命周期换取供给连续性。	S4
美国/晶圆厂	Micron 美国投资加速	2035 年前晶圆厂和技术投资 > 2,500 亿美元；目标 40% DRAM 在美国生产。	关注纽约、Idaho 开工和首片晶圆、设备搬入、人才与电力。	S5
美国/材料	Micron 供应链战略投资	最高 30 亿美元；向 GlobalWafers America 300mm 项目提供 5 亿美元融资支持。	上游硅片由采购项目变成资本合作和长期供给安排。	S6
欧洲/制造	Intel Leixlip 升级	投资 50 亿欧元，升级既有工厂并安装领先设备。	验证 Intel 3 产品、Xeon 6 和下一代 Xeon 的量产与客户需求。	S7
中国/IPO	基本半导体港股上市	全球发售 27,386,200 股 H 股。	关注 SiC 车规客户、产能利用率、良率和募集资金用途。	S21
中国/IPO	晶合集成 H 股全球发售	全球发售 216,167,000 股 H 股。	关注显示驱动/特色工艺需求、稼动率、ASP 和资本开支纪律。	S22
欧盟/政策	Chips Act 2.0	首版计划 13 项国家援助决定对应 > 320 亿欧元公私投资；2.0 强化协同。	政策成效应以投产、岗位、客户和区域供应链联动验证。	S17/S18

资本动作集中在客户和关键上游绑定：Micron 同时绑定汽车客户、美国制造和 300mm 硅片；Intel 在欧洲升级既有制造；中国企业通过港股融资支持功率和特色工艺。这些动作的价值取决于客户承诺、工程进度、良率和自由现金流。

十一、资本市场表现快照

口径说明：下表为 Yahoo Finance/yfinance 于 2026 年 7 月 15 日抓取的最近可得复权收盘价。美股区间为 7 月 6 日至 7 月 14 日，亚洲市场多数为 7 月 3 日至 7 月 14 日；各市场币种和交易日不同。价格受公司行动和复权影响，仅用于区间比较，不构成投资建议。

标的	代码	区间	期初	期末	涨跌幅	币种
费城半导体指数	^SOX	2026-07-06 → 2026-07-14	12,900.14	12,661.93	-1.85%	USD
NVIDIA	NVDA	2026-07-06 → 2026-07-14	195.55	211.80	+8.31%	USD
AMD	AMD	2026-07-06 → 2026-07-14	552.05	548.13	-0.71%	USD
Broadcom	AVGO	2026-07-06 → 2026-07-14	373.90	389.11	+4.07%	USD
Intel	INTC	2026-07-06 → 2026-07-14	122.20	107.76	-11.82%	USD
Micron	MU	2026-07-06 → 2026-07-14	984.75	983.12	-0.17%	USD
TSMC ADR	TSM	2026-07-06 → 2026-07-14	451.79	420.39	-6.95%	USD
ASML	ASML	2026-07-06 → 2026-07-14	1,825.07	1,775.64	-2.71%	USD
Applied Materials	AMAT	2026-07-06 → 2026-07-14	592.79	595.70	+0.49%	USD
Lam Research	LRCX	2026-07-06 → 2026-07-14	350.20	346.10	-1.17%	USD
KLA	KLAC	2026-07-06 → 2026-07-14	233.31	230.37	-1.26%	USD
Arm	ARM	2026-07-06 → 2026-07-14	322.24	281.17	-12.75%	USD
Synopsys	SNPS	2026-07-06 → 2026-07-14	442.27	425.90	-3.70%	USD
Cadence	CDNS	2026-07-06 → 2026-07-14	375.77	376.80	+0.27%	USD
Qualcomm	QCOM	2026-07-06 → 2026-07-14	186.48	178.10	-4.49%	USD
Samsung Electronics	005930.KS	2026-07-03 → 2026-07-14	309,500.00	263,000.00	-15.02%	KRW
SK hynix	000660.KS	2026-07-03 → 2026-07-14	2,425,000.00	1,913,000.00	-21.11%	KRW
TSMC	2330.TW	2026-07-03 → 2026-07-14	2,445.00	2,420.00	-1.02%	TWD

标的	代码	区间	期初	期末	涨跌幅	币种
MediaTek	2454.TW	2026-07-03 → 2026-07-14	4,170.08	3,660.00	-12.23%	TWD
Tokyo Electron	8035.T	2026-07-03 → 2026-07-14	73,200.00	71,130.00	-2.83%	JPY
Advantest	6857.T	2026-07-03 → 2026-07-14	29,345.00	29,775.00	+1.47%	JPY
SMIC	0981.HK	2026-07-03 → 2026-07-14	77.60	78.35	+0.97%	HKD
Hua Hong	1347.HK	2026-07-03 → 2026-07-14	178.00	171.50	-3.65%	HKD
北方华创	002371.SZ	2026-07-03 → 2026-07-14	816.00	774.20	-5.12%	CNY
中微公司	688012.SS	2026-07-03 → 2026-07-14	413.69	405.30	-2.03%	CNY
寒武纪	688256.SS	2026-07-03 → 2026-07-14	1,353.00	1,411.00	+4.29%	CNY
海光信息	688041.SS	2026-07-03 → 2026-07-14	325.40	340.85	+4.75%	CNY
兆易创新	603986.SS	2026-07-03 → 2026-07-14	677.77	583.99	-13.84%	CNY
长电科技	600584.SS	2026-07-03 → 2026-07-14	90.88	102.70	+13.01%	CNY

市场解读：SOX 区间下跌 1.85%，但 NVIDIA 上涨 8.31%、Broadcom 上涨 4.07%；Intel、Arm、Samsung、SK hynix、MediaTek 和兆易创新跌幅较大，长电科技上涨 13.01%。这说明总量数据强劲并未形成普涨，市场正在交易公司执行、估值、资本开支和事件兑现。

十二、供需、价格、库存、产能与风险信号

主题	本周信号	产业影响	验证指标
全球需求	5月销售额 1,206 亿美元、环比+9.2%，但 SOX 7月 6—14 日-1.85%。	基本面强与估值/事件兑现分化，不能用指数代替供需判断。	区域销售、企业收入、订单、库存。
DRAM/HBM	TrendForce 预计 2Q26 传统 DRAM 合约价环比+58%—63%，HBM 投片占比继续提升。	服务器和 AI 优先级挤压传统终端，客户加速签订长约。	合约价、HBM 认证、投片、客户预付款。
NAND/成熟存储	TrendForce 预计 2Q26 NAND 合约价环比+70%—75%，NOR/SLC NAND 仍偏紧。	企业 SSD 受益，PC、汽车和工业 BOM 承压。	企业 SSD 需求、库存、车规交期。
先进封装/测试	封装测试设施数据库发布，测试设备预测增速高于 WFE。	产能规划和测试节拍会约束 AI 芯片可交付量。	CoWoS 产能、测试时长、良率、设备订单。
材料连续性	300mm 硅片融资支持和化工监管延期同时出现。	上游材料成为区域化制造的先决条件。	双源认证、库存、政策清单、长约。
政策/关税	Section 232 既有 25%措施仍在；截至截稿未找到本周新的官方税率调整。	企业应持续做物项、最终用途和豁免条件核验，避免把传闻写入报价。	官方公告、海关口径、客户合同。
工程执行	美国和欧洲项目规模大、工期长。	设备、能源、厂务、人才和当地许可可能延后收入兑现。	开工、设备搬入、首片晶圆、良率。

供需判断要同时看数量、价格、库存、长约和产能兑现。销售额创新高证明需求强，长约和上游融资证明企业担忧连续供应；但资本项目周期长、股票表现分化，说明市场已经开始区分‘需求存在’和‘企业能否兑现利润’。

十三、管理观察与行动建议

- 供应保障应覆盖产能与材料配置。Micron-Ford、Micron-GlobalWafers 两类安排显示，头部企业同时使用长约、融资支持、本地化产能和产品生命周期承诺；一级供应商管理不足以覆盖风险。

- 资本项目应建立工程里程碑台账。对美国、欧洲晶圆厂和封装测试项目，按开工、设备搬入、首片晶圆、客户认证、量产良率和现金流六个节点评估有效产能。

- 存储采购要区分 HBM、服务器 DRAM、企业 SSD、车规内存和成熟存储。不同产品的认证周期、产能替代性和价格机制不同；统一议价会掩盖真正的缺口与库存风险。

- 对 AI 基础设施项目，应把先进封装、测试、网络、功率、散热和材料列入与 GPU 同级的交付清单。最慢环节决定系统交付进度。

- 对政策信息保持可审计口径。关税、出口管制、环保缓期和补贴都应落实到物项、法人、最终用途、工厂和生效日期，不以媒体标题替代法务与供应链核验。

对象	建议
企业经营者	对 HBM/DRAM、300mm 硅片、先进封装测试、高纯化学品建立二级供应地图；对关键料分别设定长约、双源、库存和替代设计。
供应链负责人	把供应商评估从价格/交期扩展到资本开支、工程里程碑、区域合规、客户集中度和产品生命周期承诺。
投资与研究团队	将每项资本公告拆成‘规模—时间—产能—客户—良率—现金流’，并区分公司官方事实、协会预测和研究机构估计。
管理咨询团队	围绕产能爬坡、良率、S&OP、材料双源、研发项目组合、全球工厂协同和供应链风险设计可量化改善项目。

公众号 · BEST变革力量

十四、半导体知识点

战略客户协议（SCA）

一句话定义：半导体供应商与客户围绕长期容量、产品路线、供货优先级和商业条件签订的中长期协议。

为什么本周重要：Micron 与 Ford 的协议说明汽车客户正在用长期承诺换取内存与存储的连续供应。

企业/投资/管理含义：企业不应把 SCA 等同于普通采购框架；需评估预付款、最低采购量、价格机制、产品变更和客户集中度。

300mm 原始硅片供应保障

一句话定义：300mm 原始硅片是先进逻辑和 DRAM 制造的基础材料，其认证周期、缺陷水平和供给稳定性直接影响晶圆厂扩产。

为什么本周重要：Micron 向 GlobalWafers America 提供 5 亿美元融资支持，说明硅片已从通用采购品升级为战略产能。

企业/投资/管理含义：晶圆厂应同步管理硅片长约、第二来源、区域供应、质量认证和扩产节拍；投资评估需关注利用率和客户绑定。

十五、下周待跟踪信号

TSMC 将于 7 月 16 日发布 2Q26 实际业绩，重点核验收入 390 亿—402 亿美元指引、毛利率 65.5%—67.5%、先进节点与 CoWoS 供需。[S9]

- Intel 计划 7 月 23 日发布 2Q26 业绩，重点核验 Foundry 亏损、Intel 3/18A 客户进度、爱尔兰投资节奏和资本开支。[S7][S25]

- AMD 将于 7 月 22—23 日举行 Advancing AI 2026 活动、8 月 4 日发布 2Q26 业绩；跟踪 AI 加速器、服务器 CPU、网络与软件生态。[S11][S26]

- Samsung 将于 7 月 30 日发布 2Q26 完整业绩；核验 HBM、DRAM/NAND 分部收入、毛利、库存和资本开支是否支持初步指引。[S2][S3]

- Micron 纽约和 Idaho 项目需按季度跟踪工程进度、设备搬入、首片晶圆、联邦/地方资金和人才供给。[S5]

- Micron-GlobalWafers 融资支持需跟踪产线认证、产能爬坡、长期供给条款及其对 300mm 硅片区域价格的影响。[S6]

- HBM4/HBM4E 进入客户认证和 2027 年产能谈判阶段，需跟踪三大供应商投片、封装良率、客户共同设计和价格机制。[S8][S15]

- 美国 Section 232 和材料监管缓期需持续核验正式清单、豁免和生效口径，避免把政策信号直接写成所有产品统一成本变化。[S19][S20]

- 基本半导体与晶合集成上市后，需跟踪募集资金投向、产能利用率、车规/显示客户、毛利率和现金流。[S21][S22]

来源附录与链接

[S1] SIA: 2026 年 5 月全球半导体销售额

[S2] Samsung Electronics: 2Q26 业绩指引

[S3] Samsung Electronics: 2Q26 完整业绩发布日期

[S4] Micron 与 Ford 签署长期战略客户协议

[S5] Micron: 加速美国投资并在纽约项目浇筑首块混凝土

[S6] Micron: 美国半导体供应链战略投资及 GlobalWafers 融资支持

[S7] Intel: 在爱尔兰 Leixlip 投资 50 亿欧元

[S8] SK hynix: 从 HBM 到 eSSD 的全栈 AI 内存战略

[S9] TSMC: 2Q26 业绩会、指引与静默期

[S10] TSMC: 2026 年月度营收

[S11] AMD: 2Q26 业绩发布日期公告

[S12] SEMI: 2026 Worldwide Assembly & Test Facility Database

- [S13] SEMI: 2026—2027 全球半导体设备销售额预测
- [S14] TrendForce: 2Q26 DRAM 与 NAND 合约价预测
- [S15] TrendForce: HBM 投片占比与 HBM4 谈判观察
- [S16] TrendForce: NOR Flash 与 SLC NAND 价格观察
- [S17] 欧盟委员会: European Chips Act
- [S18] 欧盟委员会: Chips Act 2.0
- [S19] 美国白宫: 面向半导体等关键行业的化工监管缓期
- [S20] 美国白宫: 半导体及相关产品 Section 232 措施
- [S21] 港交所: 深圳基本半导体上市文件
- [S22] 港交所: 合肥晶合集成全球发售文件
- [S23] Rapidus: 关于媒体所述晶圆价格的澄清
- [S24] 新加坡 EDB: 2026 年 5 月制造业表现
- [S25] Intel: 2Q26 业绩发布日期
- [S26] AMD: Advancing AI 2026 活动与投资者新闻
- [S27] ASML: 财务结果页面